



VIA Technologies, Inc.

VIA presenta il kit di sviluppo VIA Edge AI con processore Qualcomm® Snapdragon™ 820E Embedded Platform

Un kit in grado di accelerare il time-to-market e di ridurre i costi di sviluppo di soluzioni quali videocamere smart, chioschi interattivi, digital signage e riprese video intelligenti.

Milano, 10 maggio 2018 - VIA Technologies, Inc., presenta il kit di sviluppo VIA Edge AI, un modulo altamente integrato con processore Qualcomm® Snapdragon™ 820E Embedded Platform che semplifica la progettazione, il testing e l'implementazione di sistemi e dispositivi Edge AI.

Il kit combina il modulo SOM VIA SOM-9X20 e la scheda SOMDB2 con un modulo camera da 13MP ottimizzato per l'acquisizione, l'elaborazione e l'analisi intelligente e in tempo reale dei video. Il kit Include un pacchetto di sviluppo software per Android 8.0 con supporto per Snapdragon Neural Processing Engine (NPE) e garantisce lo sviluppo di incredibili applicazioni AI grazie al pieno controllo di Qualcomm® Hexagon™ DSP, Qualcomm® Adreno™ 530 GPU e Qualcomm® Kryo™ CPU. Un pacchetto di sviluppo Linux basato su Yocto 2.0.3 sarà rilasciato il prossimo giugno.

*"Il kit di sviluppo VIA AI Edge riduce i costi e semplifica la progettazione, il testing e l'implementazione di sistemi e dispositivi Edge AI di prossima generazione," ha dichiarato **Richard Brown, Vice-President of International Marketing, VIA Technologies, Inc.** "I componenti hardware e software sono in un unico pacchetto, ciò rende possibile lo sviluppo e l'ottimizzazione di soluzioni video intelligenti quali videocamere smart, chioschi interattivi, digital signage e riprese video intelligenti."*

Disponibilità e prezzi

VIA Edge AI Developer Kit è disponibile sullo store VIA Embedded in due configurazioni:

- VIA SOM-9X20 SOM Module e SOMDB2 Carrier Board con modulo camera CMOS a 13MP (COB 1/3.06" 4224x3136 pixel): US\$629 escluse le spese di spedizione
- VIA SOM-9X20 SOM Module e SOMDB2 Carrier Board: US\$569 escluse le spese di spedizione
- Schermo opzionale MIPI LCD touch da 10.1 pollici: US\$179 escluse le spese di spedizione.

È inoltre disponibile un set completo di servizi di personalizzazione hardware e software che velocizzano i tempi di commercializzazione e riducono al minimo i costi di sviluppo.

VIA SOM-9X20

VIA SOM-9X20 utilizza Qualcomm Snapdragon 820. Il modulo misura soltanto 8,2 cm x 4,5 cm, e include una memoria flash eMMC da 64 GB e 4GB di SDRAM LPDDR4, oltre a numerose possibilità di espansione della sezione I/O e dei display grazie al connettore pin MXM 3.0 314, che include USB 3.0, USB 2.0, HDMI 2.0, SDIO, PCIe, MIPI CSI, MIPI DSI e un pin multifunzione per UART, I2C, SPI e GPIO.

Maggiori informazioni sulla soluzione VIA SOM-9X20:

<https://www.viatech.com/en/systems/smart-cameras/vpai-home-smart-doorbell/>

Le immagini relative a questo annuncio sono disponibili qui: <https://www.viagallery.com/som-9x20/>

A proposito di VIA Technologies, Inc.

VIA Technologies, Inc è il principale fornitore di piattaforme per processori x86 a elevata efficienza energetica innovativi e all'avanguardia nei mercati PC, client, ultra mobile e sistemi embedded. La combinazione di processori a risparmio energetico con chipset per media digitali e connettività avanzata, multimedia e networking abilita un ampio spettro di piattaforme informatiche e di comunicazione, incluse le sue popolari schede madri ultra compatte. Con sede centrale a Taipei, Taiwan, la rete globale di VIA collega i centri ad alta tecnologia negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, e la sua base di clienti include i principali OEM e integratori di sistemi a livello mondiale. www.viatech.com

Per ulteriori informazioni

Tania Acerbi, Francesco Petruzzi

Prima Pagina Comunicazione

Piazza Giuseppe Grandi 19

20129 Milano

Tel. +39 02 91339811

Fax +39 02 76118304

Email: tania@primapagina.it, francesco@primapagina.it

I nomi di aziende e prodotti citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari.